

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由2026年4月18日调整为2028年12月31日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606号），公司获准发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，本次发行GDR 14,339,500份，对应的A股基础股票28,679,000股，每份GDR发行价为15.00美元，共计募集资金21,509.25万美元，扣除承销费用116.15万美元后的募集资金为21,393.10万美元，已由主承销商HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED HONG KONG于2023年4月19日汇入本公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用181.67万美元后，公司本次募集资金净额为21,211.43万美元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。

二、募集资金的使用情况

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金的使用情况如下：

金额单位：万美元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装	12,726.86	12,726.86	4,006.59	31.48%	2026年4月18日
2	海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设	2,121.14	2,121.14	0	0.00%	2026年4月18日
3	补充营运资金及其他一般公司用途	6,363.43	6,363.43	6,363.43	100.00%	—
合计		21,211.43	21,211.43	10,370.02	—	—

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的基本情况

本次进行延期的募集资金投资项目为“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”和“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”。调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预计可使用状态时间	调整后项目达到预计可使用状态时间
1	发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装	2026年4月18日	2028年12月31日
2	海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设	2026年4月18日	2028年12月31日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

1、“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目

本项目主要定位于满足海外客户需求，聚焦小信号、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等功率半导体产品，助力公司持续开拓海外市场、完善全球产能布局、提升全球市场核心竞争力。为确保募集资金使用的合理性、安全性及合规性，公司坚持“审慎推进、精准投入”的原则，有序推进项目的建设工

作。本募投项目前期已经履行充分的可行性论证程序，论证过程符合相关法律法规及公司制度要求，具备明确的实施基础和市场前景。但在项目实际执行过程中，受多重客观因素影响，募集资金使用进度较原计划有所放缓：一是受外汇管理政策要求，公司通过 GDR 发行所获得募集资金先期全部汇入境内，后续根据项目投资建设的实际需求，严格履行资金出境相关审批流程，再投入越南工厂建设；二是受越南对外商投资的监管政策和项目建设进度要求，为确保项目顺利推进和建设，保障产能落地，公司以自有资金投入部分项目建设。

目前，公司越南封装基地 MCC(越南)工厂已量产，该工厂专注功率器件和小信号半导体封装产品的研发、制造，已具备一定的产能规模和市场交付能力。未来，公司将充分结合海外市场需求、客户拓展情况，以及海内外产能供给等因素，合理安排投资进度。为提高资金使用效率，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究、充分论证，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月 18 日延长至 2028 年 12 月 31 日。

2、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目

本项目主要服务于公司两项海外核心投资需求，一是海外研发中心基础设施建设、相关设备、软件投入、招聘研发人员、产品研发及测试以及其他开支等；二是持续扩大公司的海外销售网络及售后服务网络的建设，加强海外销售网络的布局，提升海外市场服务能力。

本募投项目前期已完成充分的可行性论证，结合公司全球化战略布局、市场开发趋势、先进研发需求等，制定了切实可行的实施计划。但在实际执行过程中，受资金出境审批流程、全球经济环境变化等因素影响，公司前期以自有资金投入部分项目建设。目前，公司已在全球 50 多个国家/地区设立了在地化研发与销售网络，其中研发中心 7 个，对研发中心和售后服务网点的后续规划仍在持续推进过程中，公司本着审慎使用募集资金的原则，经审慎研究决定，拟将本募投项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月 18 日延长至 2028 年 12 月 31 日。

（三）部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目”，公司对“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目和“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目进行了重新论证。具体如下：

1、“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目

（1）项目实施必要性

近年来，随着国际贸易摩擦加剧、全球贸易环境持续多变，多元化生产地布局成为国际企业分散海外出口业务风险、实现全球化战略可持续发展的关键举措。2025 年度，公司海外业务实现销售收入 164,591.68 万元，占公司营业收入的比重为 23.08%，海外业务已成为公司经营发展的重要支柱。海外生产基地的建设，能够助力公司实现海外供应链的持续稳定和高效生产，进一步提升公司的持续经营能力和全球供应链地位。

越南作为东南亚工业的重要聚集区，具有显著的人口优势、区位优势及有利的贸易条件，能够有效降低公司海外制造的生产成本，提升产品海外交付效率，增强公司产品在国际市场的竞争力。因此，本项目的持续建设，将有利于公司进一步深化出海战略，优化全球产能布局，应对国际贸易环境变化带来的挑战，进一步提升参与国际竞争的综合实力，符合公司长远发展战略。

（2）项目建设的可行性

公司于 2023 年在越南取得投资许可并启动项目建设，布局海外生产基地。公司已充分熟悉越南对外商投资的监管政策、产业政策及相关审批流程，能够有效规避政策风险。越南地处东南亚核心区域，物流运输较为便捷，能够快速响应海外客户的交付需求；同时，越南充足的劳动力资源和相对较低的劳动力成本能够有效控制运营成本，提升公司盈利水平。越南与多个国家和地区签订了自由贸

易协定，有利于公司产品依托当地区位优势，降低出口关税成本，进一步拓展海外市场。

经过几年的发展，公司海外封装基地 MCC(越南)工厂已实现量产，专注功率器件和小信号半导体产品的研发制造，目前已实现月产能 12 亿只的规模，产能和产品良率都稳步提升。2025 年 10 月，公司越南工厂一期满产即实现盈亏平衡，2025 年全年实现销售收入近 2 亿元，展现出良好的运营效益和市场竞争力。经过多年的建设，公司已经在越南组建了专业的生产管理团队，积累了成熟的海外生产基地建设、运营及管理经验，能够为项目的持续建设和运营提供有力支持。

公司深耕海外市场多年，在全球市场积累了一批优质、稳定的 TOP 客户，产品远销全球多个国家和地区，MCC 海外品牌影响力持续提升。随着越南工厂建设的深化，MCC 海外 IDM 全产业链布局将进一步完善，将形成“晶圆制造 + 封装测试”一体化能力。公司将依托在地化生产优势，降低海外产品交付风险，进一步提升公司的整体市场竞争力与抗风险能力。

(3) 预期收益

结合当前市场环境及公司业务布局，公司在对项目投资进度进行合理调控的同时，对项目预期效益进行了再次评估，项目评估结果仍具有良好的效益预期，本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响，该项目建成后，将进一步完善公司海外 IDM 制造体系，提升公司海外生产效率与盈利水平。公司将持续关注募投项目延期的潜在影响，并在后续实施过程中审慎推进，确保项目资源的有效利用和价值的合理实现。

(4) 重新论证的结论

经过公司重新论证，公司认为“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目符合公司战略发展的需要，仍然具备投资的可行性和必要性，公司决定将继续实施上述项目并延长实施期限。同时，公司将密切关注行业市场环境及国际经济环境的变化，对募投项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督，确保募投项目的合规、有序推进。

2、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目

(1) 项目实施必要性

为加快推进公司全球化战略布局，提升公司全球核心竞争力，本项目通过建设海外研发中心与全球销售及售后服务网点，旨在实现“研发贴近前沿、服务靠近客户”的双重目标，一方面，海外研发中心的建设能够使得公司贴近国际技术前沿与获取海外高端人才资源，快速捕捉全球功率半导体技术发展趋势和创新能力，提升公司的创新效率与定制化响应能力，助力公司抢占行业高端需求；另一方面，全球销售及售后服务网点的建设保障公司能够深入拓展海外市场，强化品牌国际影响力，依托本地化服务及时响应客户需求、解决客户痛点，增强客户信任和粘性。二者协同发力，将构建“前哨研发+本地服务”的全球化网络体系，持续支撑公司在功率半导体市场的全球竞争力与业务增长，符合公司长远发展战略。

(2) 项目建设的可行性

公司积极响应国家“国内国际双循环相互促进发展”的号召，持续拓展国际业务、优化海外网点布局，加速海外研发中心建设。公司已在全球 50 多个国家/地区设立了在地化研发、制造与销售网络，其中研发中心 7 个。经过多年的海外运营，公司已经积累较为成熟的海外研发及营销服务网点运营经验，建立了完善的研发体系及运营管理制度，为本项目继续建设提供了丰富的经验支撑。

公司作为国内功率半导体行业的优势企业，拥有一支高素质、专业化的研发团队，在产品研发、技术创新方面具备较强的实力。同时，公司通过海外研发中心的建设，能够吸引全球范围内的高端研发人才，组建国际化研发团队，依托当地的技术资源和创新环境，提升公司的整体研发水平和技术创新能力。公司已建立完善的研发激励机制，能够有效激发核心研发人才的动能，保障海外研发中心的稳定运营和持续创新。

公司在全球范围内拥有完善的供应链体系和合作伙伴资源，能够为销售及售后服务网点的建设、运营提供有力的资源支持，确保项目顺利推进。此外，公司已以自有资金先行投入部分项目建设，为项目后续实施积累了宝贵的实践经验，进一步提升了项目建设的可行性。

(3) 预期收益

本项目不产生直接收益。项目效益主要体现在提升公司在研发能力建设、销售网络布局及售后服务体系搭建等方面的核心竞争力。

(4) 重新论证的结论

经过公司重新论证，公司认为“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目符合公司战略发展的需要，仍然具备投资的可行性和必要性，公司决定继续实施上述项目并延长实施期限。同时，公司将密切关注行业市场环境及国际经济环境的变化，对募投项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督，确保募投项目合规、有序地推进。

(四) 后续投资计划及保障措施

为了把控募集资金投资项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率，公司将“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月 31 日。尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，公司将根据实际实施进度分阶段投入。本次延期后，公司将实时关注募投项目的实施进展，加强对项目实施过程中的动态管理和监督，保障募集资金投资项目延期后能够按期完成。

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、审议程序及相关意见

1、审计委员会意见

2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：

本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意将募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 4 月 18 日调整为 2028 年 12 月 31 日，并同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会意见

2026 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 4 月 18 日调整为 2028 年 12 月 31 日。根据相关规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日